EUROPEAN PATENT OFFICE

5011328ZK

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

62128139

PUBLICATION DATE

10-06-87

APPLICATION DATE

29-11-85

APPLICATION NUMBER

60267333

APPLICANT: TOSHIBA CORP;

INVENTOR:

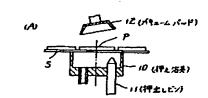
SUZUKI TOGO;

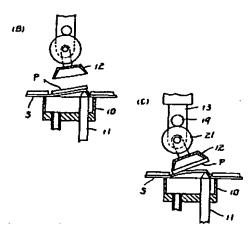
INT.CL.

H01L 21/68

TITLE

PEELING DEVICE





ABSTRACT:

PURPOSE: To easily peel a tiny element from a flexible sheet by a method wherein the circumference of a tiny element bonded to the flexible sheet is pushed from the side of the sheet by an extruding pin eccentrically attached to a pressing jig and the tiny element is sucked and held to a vacuum pad tiltably movable as required.

CONSTITUTION: A pressing jig 10 moves toward a sheet S. The pressing jig 10 temporarily supports a semiconductor pellet P when an opening is in close contact with the sheet S. A vacuum pad 12 is caused beforehand to be inclined at the same angle as the semiconductor pellet P and is so adjusted as to be positioned over the semiconductor pellet P that is inclined owing to an extruding pin 11. The vacuum pad 12, upon adsorption of the semiconductor pellet P thereto, is caused to gradually incline, for the semiconductor pellet P to be peeled from the sheet S little by little. A support 13 travels along the direction of the axle of the pressing jig 10 and the direction orthogonal to the axle. When a proper quantity of the semiconductor pellet has been peeled from the sheet S, the pad 12 is caused to stop inclining, the support 13 recedes along the direction of the axle, for the complete peeling of the pellet P from the sheet S.

COPYRIGHT: (C)1987, JPO& Japio

THIS PAGE BLANK (USPTO)

19日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 128139

@Int,Cl,4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和62年(1987)6月10日

H 01 L 21/68

7168-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

9発明の名称 剝離装置

②特 願 昭60-267333

20出 願 昭60(1985)11月29日

 ⑩発明者 鈴木 東吾

 ⑪出願人 株式会社東芝

横浜市磯子区新杉田町8 株式会社東芝生産技術研究所内

川崎市幸区堀川町72番地

砂代 理 人 弁理士 井上 一男

明 細 質

1. 発明の名称

利雅装置

2. 符許請求の範囲

 発明の詳細な説明 (発明の技術分野) この発明は、柔軟性シートに貼着された半導体 ペレットの如き微小部材をシートから剥離する剥 離装置に関する。

(発明の技術的背景とその問題点)

半導体装置は、鏡面研磨された半導体ウェハの表面に独立した複数のパターンを形成し、このウェハをビニル樹脂などからなる柔軟性シートに貼着して、上記パターンを1個づつ含む複数のペレットに分割したのち、このシートから各分割されたペレットを1個づつ割して組立てられる。

従来、このシートから各分割されたペレットを 利離するために、第4回に示す利離装置が用いら れている。この利離装置は、シート(S) に貼着さ れたペレット(P)に対して、そのシート(S) 側に接 離自在に配設され、シート(S) を真空吸着してその の上に貼着されているペレット(P) を支持する 筒 状の抑え治具(1)と、この抑え治具(1)の内側に 動かつその積方向に変位可能に取り付けられたペレット(P)側に配設され、ペレット(P)に対して接 ット(P)側に配設され、ペレット(P)に対して接

特開昭62-128139 (2)

自在なバキュームパッド(3)とからなる。

上記ペレット(P)のシート(S)からの利離は、ペレット(P)を防潜しているシート(S)に一様な張力が加わるようにシート(S)の周辺部を保持し、まず第5回(A)回に示すように、押え治具(1)を前追させてシート(S)を真空吸着し、その上に貼着されているペレット(P)の一つを支持させる。つぎに(B)回に示すように、押出しピン(2)を前追させて上記押出し治具(1)上に支持されたペレット(P)の中央部を押圧して、その前追方向に押出し、ペレット(P)をシート(S)から利離させる。しかるのち(C)回に示すように、パキュームパッド(3)を前追させて、上記シート(S)から利離したペレット(P)を吸着支持し、このパキュームパッド(3)の後退により、ペレット(P)を完全にシート(S)から利離させる。

しかしこのような剝離装置は、ペレット(P) が シリコンペレットのように化合物半導体ペレット などにくらべて機械的強度が高くかつ小形の場合、 あるいはシート(S) に対する接着力が弱い場合に は、支敵なく刺離することができるが、ペレット (P) が大形化するにつれてその剥離が困難となる。 (発明の目的)

この発明は、上配半導体ペレットのように柔軟性シートに贴着された微小部材をシートから容易に剥離できる剥離装置を構成することにある。 【発明の極感】

この発明は、柔軟性シートに貼着された微小部材の周辺部を、押え治具に偏心して取り付けられた押出しピンによりシート側から押圧して押出し、これを傾動機構により任意に傾動できるように支持体に支持されたパキュームパッドに吸着支持させることにより、微小部材をシートから容易に利益できるように到離装置を構成したものである。

以下、図面を参照してこの発明を実施例に基づ いて説明する。

(発明の実施例)

第1図にこの発明の一実施例である半導体ペレットの利離装置を示す。半導体ペレット(P) を貼むしているシート(S) は、柔軟性をもち、周辺部

が図示しない保持装置に取り付けられてシート(S) 全面に一定の張力が加わるように保持される。 利 態装図は、このシート(S) に貼着された半導体ペ レット(P)に対して、そのシート(S) 個に配設され る押え治具(10) および押出しピン(11) と、上記半 呼体ペレット(P) 側に配設されるバキュームパッド(12) およびこれを支持する支持体(13) を備える。

押え治县(10)は、シート(S) に対向する場面が 開口した有底微体をなし、その関口径は半導体ペレット(P) より大きい。またその底部には、これを真空装置に接続する 3 智 (15) が取り付けられている。この押え治县(10) は、矢印(A) で示すように、上記シート(S) に対して接離自在に配設され、図示しない駆動装置の駆動により前進して、上記 切っがシート(S) に密考したとき、これを吸治し、少なくとも半導体ペレット(P) を贴着している部分を開放してこの半導体ペレット(P) を一時的に支持する。

押出しピン(11)は、上記押え治具(10)の翰(16)から編心して平行に、かつ押え治具(10)の庭邸を

滑動自在に貫通して、矢印(B) で示すように、押え治具(10)に対して変位可能となっている。この押出しピン(11)は、上記押え治具(10)の関ロがシート(S) に密着してこれを吸着したとき、図示しない駆動装置により、先韓部が上記関ロから突出する如く駆動され、上記押え治具(10)の関ロ上に位置する半導体ペレット(P)の周辺部をシート(S)を介して押圧し、半導体ペレット(P) を傾斜させ

バキュームパッド(12)は、図示しない真空装置に接続された凹孔を有し、その関口をシート(S)に貼着された半導体ペレット(P) 例にしている。この閉口は、上記半導体ペレット(P) とほぼ同じ大きさである。またこのバキュームパッド(12)は、その背面にこれを支持体(13)に取り付けるアーム(18)を有する。

支持体(13)は、先端部に上記パキュームパッド(12)を回転自在に支持し、この支持体(13)の中間部に取り付けられた窗車(19)およびこの歯単(19)に歯合してパッド支持軸(20)に取り付けられた歯

特開的62-128139(3)

取(21)からなる領動機構を介して、図示しない駆動装置により、矢印(C)で示すようにバキュームパッド(12)を領動させることができるようになっている。またこの支持体(13)は、上記領動とは独立に、図示しない駆動装置により、矢印(D),(E)で示すように前記押え治具(10)の軸方向およびこの軸方向と直交する方向に動かす移動機構を有する。

つぎに第2図によりこの剥離装置の動作につい て述べる。

まず、(A)図に示すように、シート(S)に貼着されている所要の半導体ペレット(P) に対して刺離 装置の押え治具(10)が同額になるように、刺離 設置またはシート(S) を保持する保持設置を動かす。しかるのち、押え治具(10)を前違させてその問口をシート(S)に密着させ、さらにこの押え治具(10)に接続された真空装置の吸引により上記シート(S)を吸着させる。

つぎに(B) 図に示すように、押出しピン(ii)を その先端部が押え治具(i0)の関口から突出する如 く前進させ、上記押え治具(10)上の半導体ペレット(P)をシート(S)を介して押圧し、これをその前 地方向に押出す。このとき、押え治具(10)に対して偏心している押出しピン(11)は、半導体ペレット(P)を一定角度傾斜させる。またこの傾斜とともに、この半導体ペレット(P) を贴着している系軟性シート(S)は、轉接する半導体ペレット(P)または切り残し部との間で伸長する。

つぎに(C) 図に示すように、支持体(13)に取り付けられたパキュームパッド(12)を押え治具(10)の輸方向に前遠させて、上記傾斜した半導体ペレット(P) を吸着支持させる。この半導体ペレット(P) を吸着支持するとき、パキュームパッド(12)は、あらかじめ、上記半導体ペレット(P) の傾斜内と同じ角度傾斜しており、かつこの傾斜したパッド(12)が押出しピン(11)の押出しにより傾斜した半導体ペレット(P) 上に位置調整されている。

パキュームパッド(12)に半導体ペレット(P) が

吸着支持されると、支持体(13)は、この支持体(13)に設けられた傾動機構を介して、上記パキュームパッド(12)をその傾斜角が大きくなる方向に徐々に傾動させ、半導体ペレット(P)をシート(S)から少しづつ引き剥す。このとき、パキュームパッド(12)に吸着支持された半導体ペレット(P)が、シート(S)を押すことがないように、上記パキュームパッド(12)の傾動にあわせて、支持体(13)は、押え治具(10)の軸方向およびこの軸方向と直交する方向に移動する。

「かくじて半導体ペレット(P)がシート(S)から適当益利れたとき、パキュームパッド(12)の傾動を 好止し、支持体(13)を押え治具(10)の輔方向に後 迅させて、半導体ペレット(P)をシート(S)から完 金に引き刺す。

なおこの判離装置の各部の復元動作は、上記剥離動作の説明から容易に理解できるので、その説明を省略する。

上記のように刺離装置を構成すると、比較的小 さな半導体ペレットは勿論、比較的大きな半導体 ペレットに対しても、これを容易にシート(S) か ら割離することができる。またシート(S) への接 着力が強い場合でも、网様に剥離することができ る。すなわち、従来の利離装置は、比較的小さな 半導体:ペレットを対象としたものであり、大きな 半導体ペレットに対しては、シート(S) との接着 面積が大きいために、押出しピンで押出しても、 なおシート(S) に大きな技者面積で接着し、これ を引き剥すことが困難であった。しかし上記実施。 例に示した剥離装置を用いると、押出しピン(11) により半導体ペレット(P) を傾斜させ、この傾斜 された半導体ペレット(P) をさらに徐々に傾斜さ せて、周辺部から少しづつ剃し、シート(S) との 接着面積が十分に小さくなったのちにパキューム パッド(12)を後退させて完全に引き剥すので、半 導体ペレット(P) が大きい場合でも、またシート (S) への接着力が大きい場合でも、これを容易に 刺離することができる。

つぎに他の実施例について述べる。

上記実施例では、歯車からなる傾動機構により

特開昭62-128139 (4)

バキュームパッドを傾動させるように構成したが、 この傾動機構は、カム、リンクなど他の機構でも 構成することができる。

また上記突旋例では、押え治具(10)を一取の简体で構成したが、第3例に示すように、この押え治具(10)をシート(S) に対向する端面が関ロした環状器(22)を有する二度壁のリング状に構成し、その感状器(22)を真空装置に接続して、シート(S)を吸着支持するようにしてもよい。

なお、この発明の剥離裝置は、半導体ペレット 以外の微小部材の剥離に対しても適用できる。 (発明の効果)

条軟性シートに貼着された微小部材をシート例から押圧して傾斜させ、この傾斜した微小部材をバキュームパッドに吸着支持させて、さらに傾斜させることにより、微小部材の周辺部からシートをなったのちにパキュームパッドを後退させて完全に引き刺すように構成したので、シートとの接着面積が大きい場合でも、またシートへの接着力

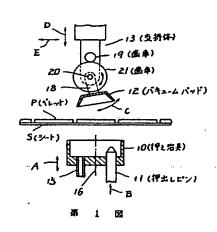
が強い場合でも、微小部材を容易に利離すること ができる。

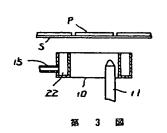
4. 図面の簡単な説明

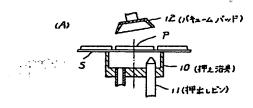
第1 図はこの発明の一実施例であるシートに貼者された半導体ペレットをシートから刺離する利離装置の構成を示す図、第2 図(A)ないし(C)図はそれぞれその動作説明図、第3 図は他の実施例の構成を示す図、第4 図は同じくシートに貼者された半導体ペレットをシートから刺離する従来の刺離装置の構成を示す図、第5 図(A)ないし(C)図はそれぞれその動作説明図である。

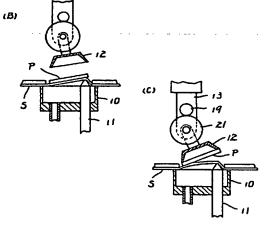
- (10) … 押入治具
- (11)…押出しピン
- (12)…パキュームパッド
- (13)…支持体
- (18)… 當車
- (21) … 雷車
- (P)…半導体ペレット
- (S) … シート

代邓人 井珥士 井 上 一 男



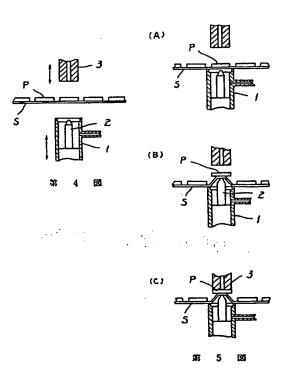






as 2 🖾

特開昭62-128139 (5)



-175-

THIS PAGE BLANK (USPTO)